



# 鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

## 导热吸波 常规系列

### 【导热吸波垫片】规格书



- 产品图 -

鸿富诚 **导热吸波** 系列，是一种复合吸波垫具有导热性和吸波性。具有良好的弹性和压缩性。当芯片本身的抗辐射要求较低或被辐射的要求较低时，复合材料可以简化整个模块结构。

#### 应用领域推荐：

- 通讯设备
- 光电行业
- 网通产品
- 高频模块
- 软性电路板

#### 产品性能

NO.	参 数			单 位	测试方法	
	H100A15	H150A15	H200A15			
颜 色	深灰色	深灰色	深灰色	--	目视	
厚 度	0.5~3.0	0.5~3.0	0.5~3.0	mm	ASTM D 374	
密 度	2.5±0.2	3.2±0.2	3.4±0.2	g/cc	ASTM D 792	
硬 度	40~60 (±5)	40~60 (±5)	40~60 (±5)	Shore C	ASTM D 2240	
压缩比	≥15 (@50psi)	≥15 (@50psi)	≥15 (@50psi)	%	ASTM D 695	
拉伸强度	≥0.5	≥0.5	≥0.3	MPa	ASTM D 412	
延伸率	≥100	≥100	≥70	%	ASTM D 412	
撕裂强度	≥1.5	≥1.0	≥0.6	N/mm	ASTM D 624	
磁导率	15±5	15±5	15±5	@1MHz	SJ 20512	
吸收频段	100-18G	100-18G	100-18G	MHz	GJB 2038A-2011	
反射损耗	@5GHz	31	29	59.5	dB/cm	--
	@15GHz	94.88	69	51.8	dB/cm	--
防火性能	V0	V0	V0	--	UL 94	
使用温度	-40~160	-40~160	-40~160	°C	IEC 60068-2-14	
短期耐高温	250	250	250	°C	IEC 60068-2-14	

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

**储存条件：**阴暗处储存，

储存温度：≤30°C；

储存湿度：≤70%；

**保质期：**

在储存条件下：2年

不符合储存条件下：6个月

#### 热学特性

导热系数	1.0±0.2	1.5±0.2	2.0±0.2	W/m·K	ASTM D 5470
热 阻	≤2.0 (@20Psi/1mm)	≤1.5 (@20Psi/1mm)	≤1.0 (@20Psi/1mm)	°Cin <sup>2</sup> /W	ASTM D 5470

#### 电学特性

击穿电压	< 0.1	< 0.1	< 0.1	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 <sup>10</sup>	≥10 <sup>10</sup>	≥10 <sup>10</sup>	Ω·cm	ASTM D 257
介电常数	≥2.0	≥2.0	≥2.0	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	≤0.1	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

导热吸波 常规系列

## 【导热吸波垫片】规格书



-产品图-

鸿富诚 **导热吸波** 系列，是一种复合吸波垫具有导热性和吸波性。具有良好的弹性和压缩性。当芯片本身的抗辐射要求较低或被辐射的要求较低时，复合材料可以简化整个模块结构

### 应用领域推荐：

- 通讯设备
- 光电行业
- 网通产品
- 高频模块
- 软性电路板

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

**储存条件：**阴暗处储存，

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ；

储存湿度： $\leq 70\%$ ；

**保质期：**

在储存条件下：2年

不符合储存条件下：6个月

### 频率曲线

